

SEMICON[®] JAPAN

2024

2024年12月11日(水)–13日(金)

10:00–17:00

東京ビッグサイト(東展示棟)

出展のご案内

Booth No. **2411**

ハイブリッドマテリアルの総合砥粒加工装置

FOWLP, PLP, TSVウエーハの研削

～半導体及び先端パッケージ技術の進化への対応～

FOWLP/PLP研削におけるCu+モールド樹脂加工
及び複合材平坦化技術により、IoT社会の実現へ貢献します



加工実例 積層技術に対応した、パッケージ材料、TSVウエーハ
様々な樹脂・金属・膜の複合素材

次世代高周波通信
デバイス用
ハイブリットウエーハ

ハイブリットウエーハ
(異種基板)
の総合砥粒加工装置

TSV 積層ウエーハ

オートTTVコントロールによる
高精度研削

電子部品用
各種セラミックス材料

BGテープ高精度研削

バンパウエーハの高精度加工

SiC加工のトータルソリューション

インゴットからウエーハ工程まで

Okamoto

株式会社岡本工作機械製作所

ナノプロセスグループ

〒379-0135 群馬県安中市郷原2993 TEL 027-385-6211 FAX 027-385-1144

<https://www.okamoto.co.jp>